



HAUPTVERSAMMLUNG 2013

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT

19. JUNI 2013

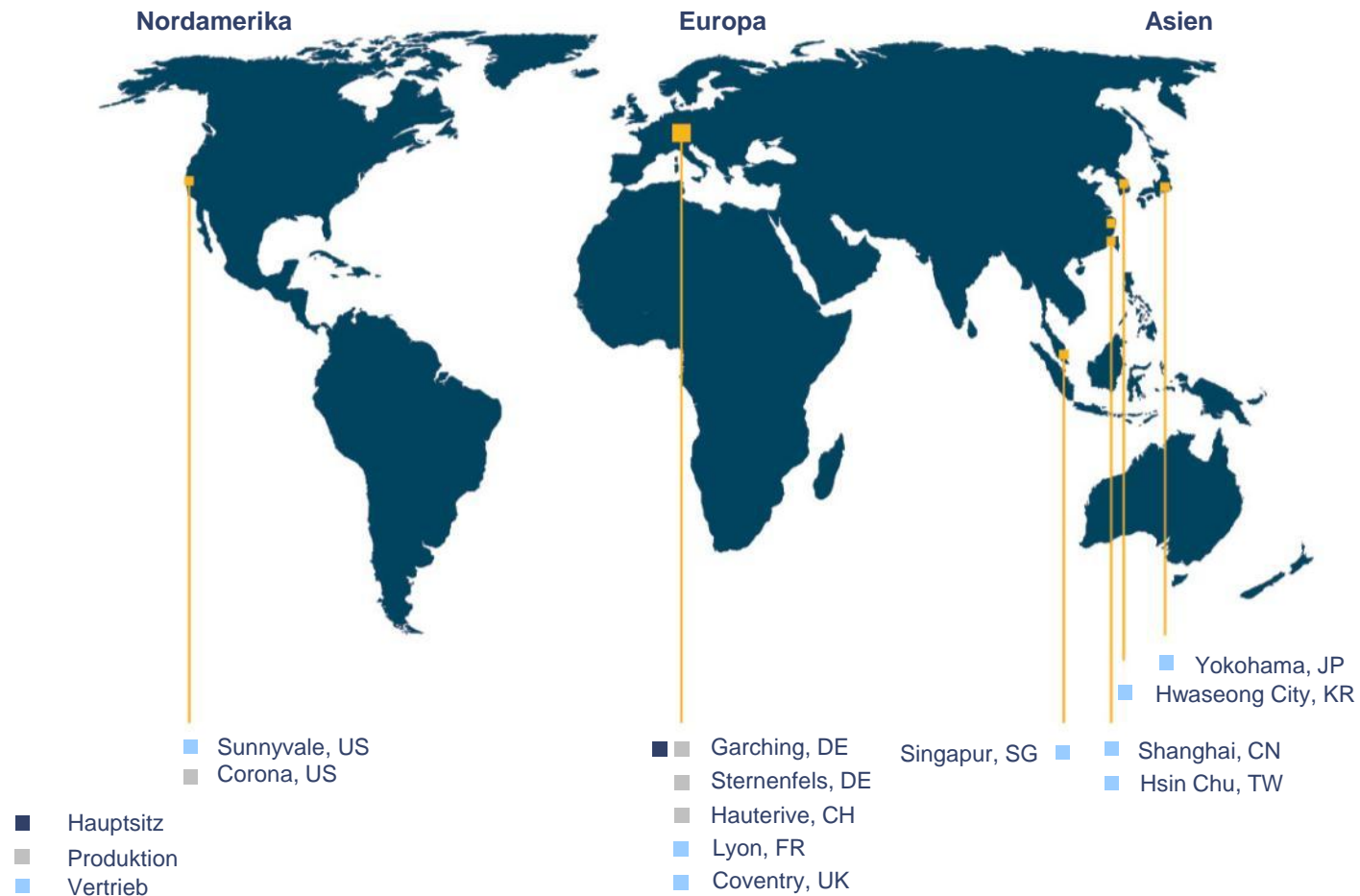
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der SÜSS MicroTec AG oder ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SÜSS MicroTec AG liegen. Die SÜSS MicroTec AG übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die SÜSS MicroTec AG beabsichtigt auch nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

- I. Überblick SÜSS MicroTec AG**
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt
- III. Meilensteine 2012/2013
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V. Das erste Quartal 2013
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. Die Aktie
- VIII. Ausblick

- + SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Anbieter für Equipment im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie
 - + Unser Equipment und unsere Prozesslösungen schaffen die Mikro- und Verbindungsstrukturen der Mikroelektronik
 - + Unser Fokus richtet sich auf die wachstumsstarken Marktsegmente: Advanced Packaging / 3D-Integration, MEMS und LED
-
- + Kennzahlen zur Aktie:
 - Bloomberg Symbol: SMHN
 - Mitglied im TecDAX
 - Aktienkurs*: 8,64 €
 - Marktkapitalisierung*: 165 Mio. €
 - Net Cash, März 2013: 25,1 Mio. €



* Mai 31, 2013



Deutschland



Garching

- + Sitz der SÜSS MicroTec AG
- + Entwicklung und Produktion:
 - **Mask Aligner**
 - **Bond Aligner**
- + Kernkompetenz:
 - **Belichtung**
(proximity exposure)
 - **Positionierung**



Sternenfelds

- + Entwicklung und Produktion:
 - **Bonder**
 - **Belacker und Entwickler**
 - **Fotomasken Equipment**
- + Kernkompetenz :
 - **Nassprozesse**
 - **Waferbonden**

USA



Corona

- + Entwicklung und Produktion:
 - **Stepper / Scanner**
 - **Laser Strukturierung**
- + Kernkompetenz :
 - **Belichtung**
(UV projection lithography)
 - **Laser Ablation**

ÜBERSICHT ÜBER DIE SEGMENTE UND PRODUKTE

Segmente	Fotomasken Equipment	Lithografie		Substrat Bonder
				
Produkte	MaskTrack Pro	Belichtungssysteme Stepper, Scanner Mask Aligner	Belacker und Entwickler	Wafer Bonder
	<div> <div>Frontend</div> <div>Mid- und Backend</div> </div>			
Prozess- schritte	Fotomasken Reinigung	UV Projektions- lithografie Laser Ablation	Proximity Belichtung Nano Imprinting	Belacken Entwickeln Bond Alignment Permanentes Bonden Temporäres Bonden
Kennzahlen 2012	Umsatz: 22,9 Mio. € EBIT: 1,1 Mio. €	Umsatz: 113,2 Mio. € EBIT: 23,7 Mio. €		Umsatz: 23,1 Mio. € EBIT: -12,0 Mio. €

- I. Überblick SÜSS MicroTec AG
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt**
- III. Meilensteine 2012/2013
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V. Das erste Quartal 2013
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. Die Aktie
- VIII. Ausblick

Digitaler Lebensstil

- Der „Digitale Lebensstil“ zeichnet sich durch eine permanente Verbindung mit dem Internet und einem Fokus auf Medien aus
- Mobile Geräte wie Smartphone und Tablet PC stellen diese Leistung zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung
- Neue Gerätegenerationen bieten höhere Funktionalität



E-Mobilität

- Alternative Transport/Mobilitätslösungen fassen durch attraktive Preis-Leistungsverhältnisse Fuß
- Elektrofahrzeuge, Hybrid-Autos, Segways, E-Bikes, aber auch Züge erhöhen sowohl den Bedarf an Leistungselektronik (Transistoren) als auch Hochleistungs-ICs



Energieeffizienz

- Höheres Umweltbewusstsein und steigende Energie- und Treibstoffpreise steigern die Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen bei elektrischen Anwendungen wie z.B. der Beleuchtung
- Energieeffizienz bei der industriellen Produktion
- Smartes Energiemanagement bei Anwendungen im Haushalt sparen Energie





~1985...heute



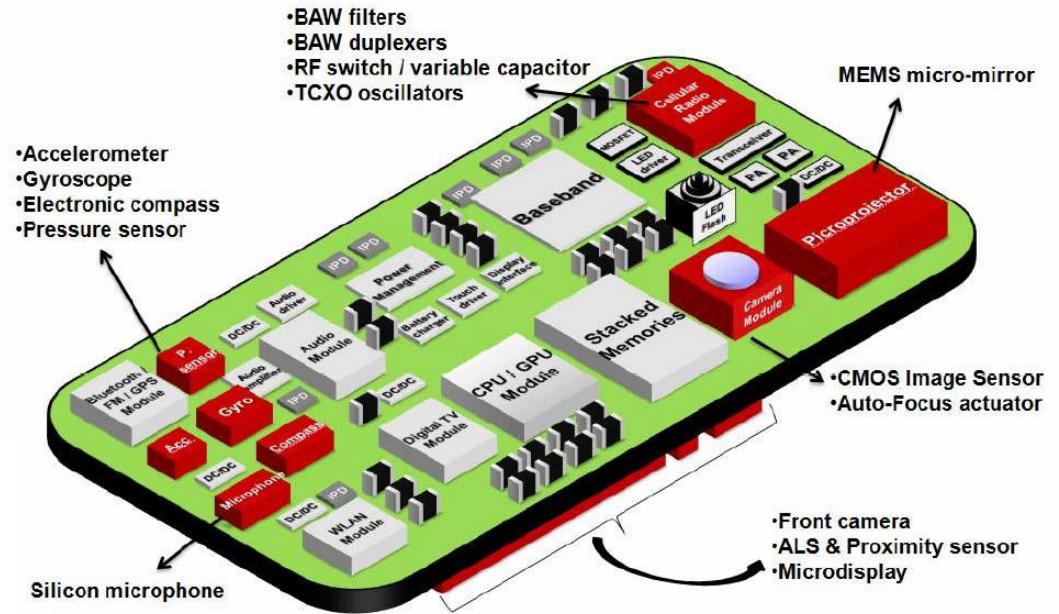
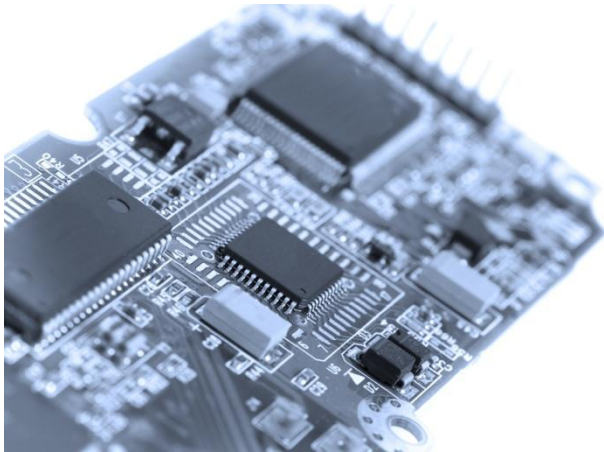
~1987...heute



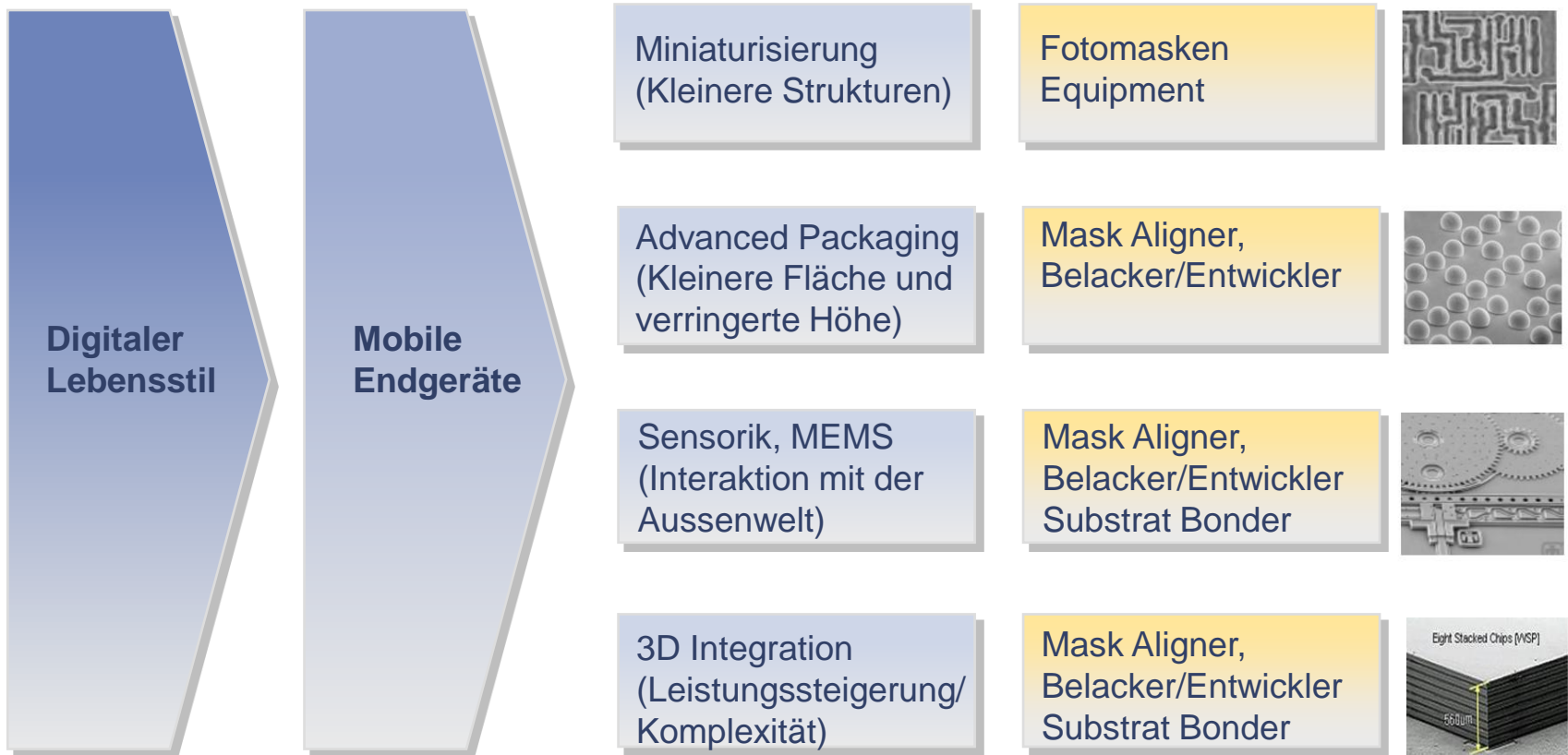
~1910...heute

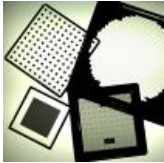
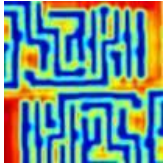
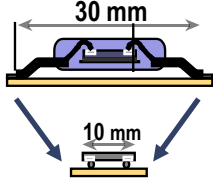
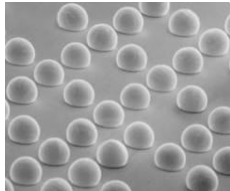
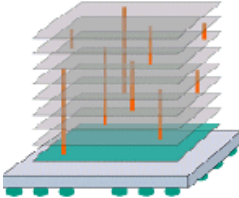
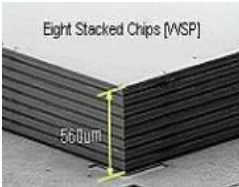


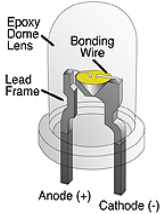



~1950...heute



Quelle: Yole Developpement



Halbleiter			Sensorik	Beleuchtung
Maskenherstellung Fotomaschinenreinigung	Advanced Packaging Micro-Bumping	3D Integration Stapeln von Mikrochips	MEMS Computer, Automobil- industrie, Medizintechnik	LED Generelle Beleuchtung HB und UHB LED
 	 	 	 	 

- I. Überblick SÜSS MicroTec AG
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt
- III. **Meilensteine 2012/2013**
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V. Das erste Quartal 2013
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. Die Aktie
- VIII. Ausblick

- + Markteinführung des XBC300 Gen2 Bond Clusters
- + Produktionsbeginn der neuen RCD8 Belacker / Entwickler Plattform
- + Dritte Generation der ACS200 Plattform vorgestellt
- + Auslieferung des hundertsten LabSpin6



XBC300 Gen2



RCD8
(Belacker und Entwickler)



ACS200 Gen3



LabSpin6

- + Stärkung des Kernsegments Lithografie durch die Akquisition von Tamarack Scientific**
- + Anteilsbesitz an SÜSS MicroOptics auf 100 Prozent aufgestockt**
- + SÜSS MicroOptics bezieht neues Produktionsgebäude, um weiteres Wachstum zu ermöglichen**
- + Kooperationen mit führenden Industrieunternehmen erweitert und intensiviert: GenISys GmbH und Dow Corning**
- + SÜSS MicroTec wird Partner der VDMA Nachhaltigkeitsinitiative: Blue Competence**



BLUECOMPETENCE

Alliance Member

Partner der Nachhaltigkeitsinitiative
des Maschinen- und Anlagenbaus

- + Kauf der Immobilie am Standort Garching**
- + International führender IDM platziert Folgeauftrag für Bonding-Equipment für die 300 mm Massenfertigung**
- + Führender US-amerikanischer IDM platziert Auftrag für umweltfreundliches System zur Excimer Laser Ablation**
- + Refokussierung der Produktlinie Permanent Bonding**



XBC300 Gen2



ELP300

- + Fokussierung des Bereichs Permanentes Bonden auf die Märkte MEMS und LED, um die unbefriedigende Ertragssituation zu verbessern**
- + Nicht Cash wirksame Abschreibungen i.H.v. 6.8 Mio. € im Q2 2013 auf aktivierte Entwicklungskosten (aus den Jahren bis 2008), Demo-Equipment und Vorräte**
- + Das Wachstum der Substrat Bonder Division wird wesentlich durch das erfolgreich in den Markt eingeführte Temporäre Bonden bestimmt werden**
- + Der Umsatzbeitrag der Produktlinie Permanentes Bonden wird anfänglich auf dem Niveau des Vorjahres erwartet**

Die Substrat Bonder Division ist nun gut positioniert, um vom erwarteten Marktwachstum der nächsten Jahre zu profitieren

MEMS, LED und 3D-IC

2D Packaging

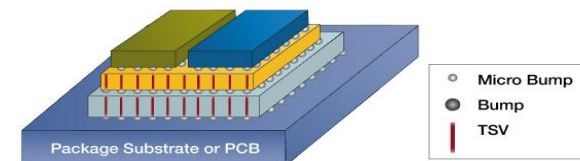
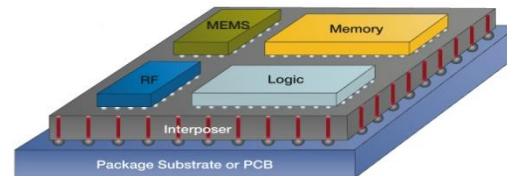
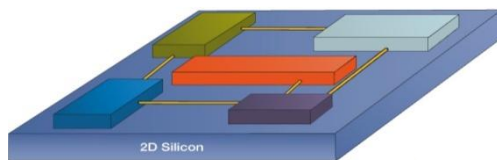
- Höhere Leistung und Komplexität der ICs durch kleinere Geometrie der Transistoren gemäß dem Moores Gesetz
- Neue Technologien wie EUV und mehrfache Strukturierung ermöglichen eine weitere Skalierung
- Durch technische Einschränkungen wird es immer schwieriger und teurer die Struktur-Größe zu verringern

2.5D Packaging

- Verbindung mehrerer (auch heterogener) Halbleiterkomponenten auf einem Interposer erweitert das Spektrum der traditionellen Verkleinerung
- Erhöhte Packaging-Dichte
- Reduzierte Grundfläche
- Komplementäre Technologie zum Moores Gesetz

3D Integration (TSV)

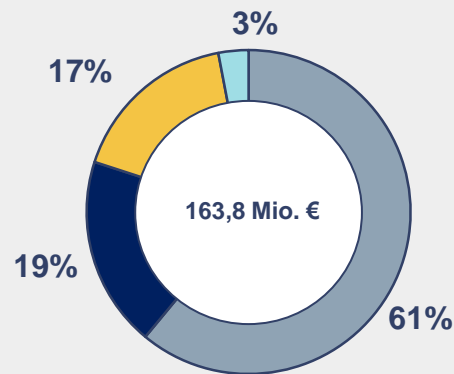
- Die Verkleinerung jenseits der Verringerung der Struktur-Größen wird "More than Moore" genannt
- Packaging wird zum Schlüssel für die Skalierung und ein Teil der Wertschöpfung verschiebt sich von der Siliziumstrukturierung zum Packaging
- Höhere Leistung und Komplexität gepaart mit einer kleineren Grundfläche
- Geringerer Energieverbrauch



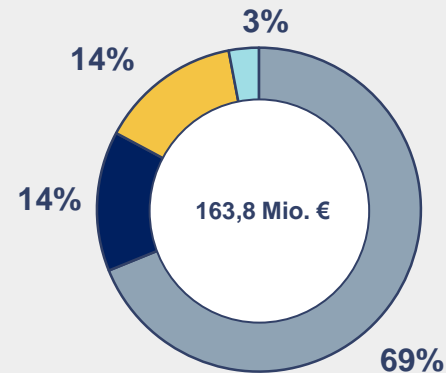
Anlagen und Prozesslösungen von SÜSS MicroTec ermöglichen eine Strukturverkleinerung in 2D ("*Moores Gesetz*") und ein Stapeln in 3D ("*More than Moore*")

- I. Überblick SÜSS MicroTec AG
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt
- III. Meilensteine 2012/2013
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen**
- V. Das erste Quartal 2013
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. Die Aktie
- VIII. Ausblick

Auftragseingang nach Segmenten

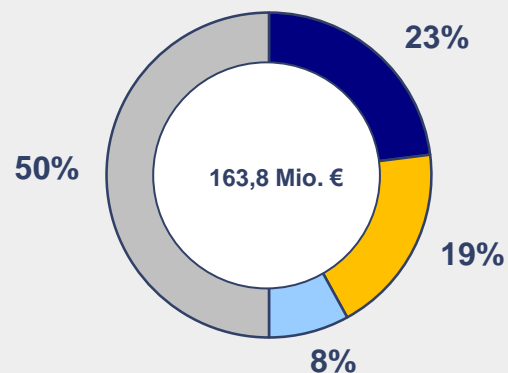


Umsatz nach Segmenten

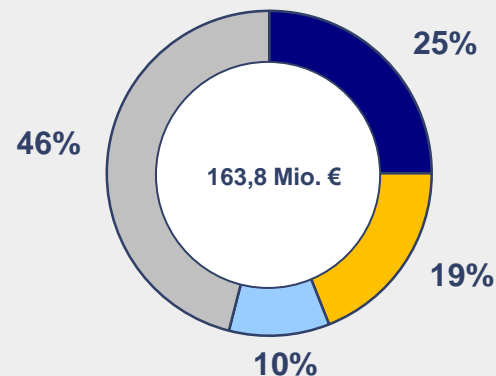


- Lithography
- Photomask Equipment
- Substrate Bonder
- Others

Auftragseingang nach Regionen



Umsatz nach Regionen



- Europe
- North America
- Japan
- Rest of Asia

in Mio. €	2012	2011	in %
Auftragseingang	157,2	143,1	+ 9,9%
Auftragsbestand zum 31.12.	86,5	83,7	+ 3,3%
Umsatz	163,8	175,4	- 6,6%
EBIT	11,7	18,6	- 37,1%
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>7,1%</i>	<i>10,6%</i>	<i>- 3,5% Pkt</i>
Ergebnis nach Steuern (fortgeführtes Geschäft)	7,6	13,8	- 44,9%
Ergebnis nach Steuern (fortgeführtes und nicht fortgeführtes Geschäft)	9,1	13,8	- 34,1%
EPS in € (fortgeführtes Geschäft)	0,40	0,72	- 44,4%
Freier Cash Flow*	-4.5	3.5	--
Nettoliiquidität**	32.3	42.0	-23.1
Mitarbeiter zum 31.12.	704	624	+ 12,8%

* vor Berücksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitäten

** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren

- I. Überblick SÜSS MicroTec AG
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt
- III. Meilensteine 2012/2013
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V. Das erste Quartal 2013**
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. Die Aktie
- VIII. Ausblick

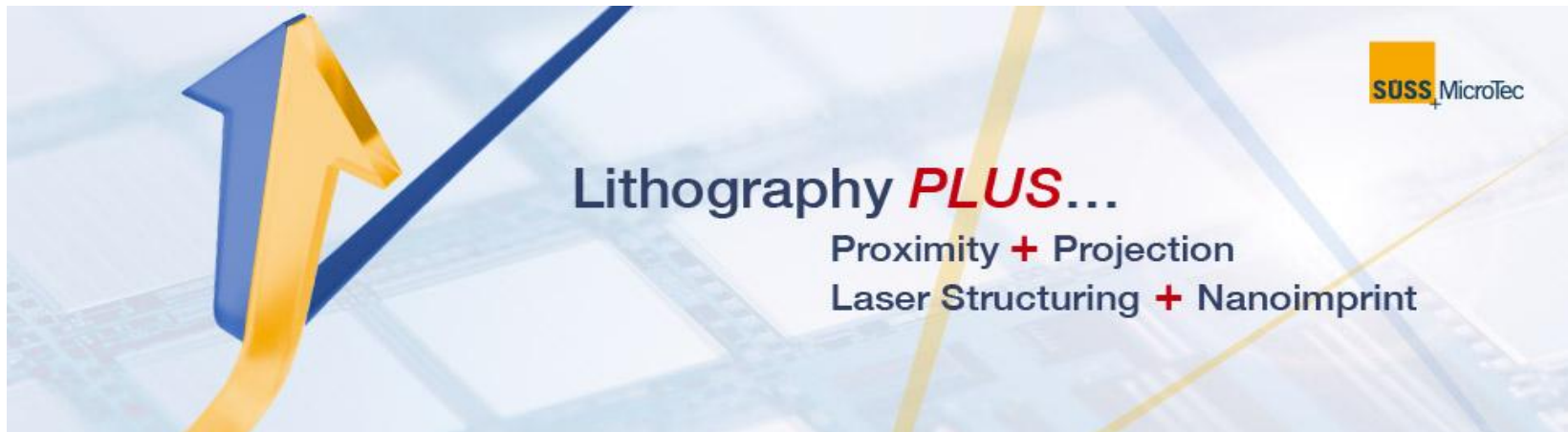
in Mio. €	Q1 2013	Q1 2012	in %
Auftragseingang	34,9	39,0	-10,5%
Auftragsbestand zum 31.03.	91,5	99,8	-8,3%
Umsatz	30,1	31,2	-3,5%
EBIT	-3,3	0,0	--
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>-11,0%</i>	<i>0%</i>	<i>--</i>
Ergebnis nach Steuern (fortgeführte Aktivitäten)	-2,5	-0,2	< -100%
Ergebnis nach Steuern (fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten)	-2,5	1,3	--
Ergebnis je Aktie in € (fortgeführte Aktivitäten)	-0,13	0,07	--
Freier Cash Flow*	-7,2	0,3	--
Nettoliiquidität**	25,1	38,5	-34,8%
Mitarbeiter zum 31.03.	693	687	0,9%

* vor Berücksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitäten

** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren, nach Akquisition von Tamarack Scientific

- I.** Überblick SÜSS MicroTec AG
- II.** Wandel durch technologischen Fortschritt
- III.** Meilensteine 2012/2013
- IV.** Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V.** Das erste Quartal 2013
- VI.** **Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie**
- VII.** Die Aktie
- VIII.** Ausblick

- + Steigende Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Halbleiterbauelementen erfordern den Einsatz von innovativen Technologien im Halbleiter Backend Equipment Markt
- + **Keine Belichtungstechnologie erfüllt alle Anforderungen gleichzeitig**
- + Ergänzung der Mask Aligner Produktlinie durch den Erwerb einer komplementären Stepper / Scanner-Produktlinie, die unser Technologieportfolio um die Schlüsselkompetenzen UV-Projektionslithografie und Laser Ablation erweitert
- + Erhöhung des Anteilsbesitzes an der SÜSS MicroOptics S.A., die für den Konzern wichtige Schlüsseltechnologien besitzt, auf 100%
- + Umzug der SÜSS MicroOptics S.A. in ein neues Produktionsgebäude, um weiteres kontinuierliches Wachstum zu ermöglichen

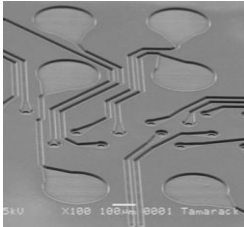


- + SUSS MicroTec Photonic Systems (ehemals Tamarack Scientific) entwickelt und fertigt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie Maschinen zur Laserstrukturierung
- + Das Unternehmen bedient die klassischen SUSS MicroTec Zielmärkte: Advanced Packaging, 3D-IC, MEMS und LED

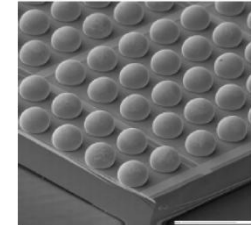
Eckdaten:

- + Standort: Corona, Kalifornien, USA
- + Umsatz: ~10 Mio. EUR (GJ 2011/12)
- + Mitarbeiter: 63
- + Kaufpreis: 9,34 Mio. USD (plus zusätzlicher variabler Kaufpreisanteil)

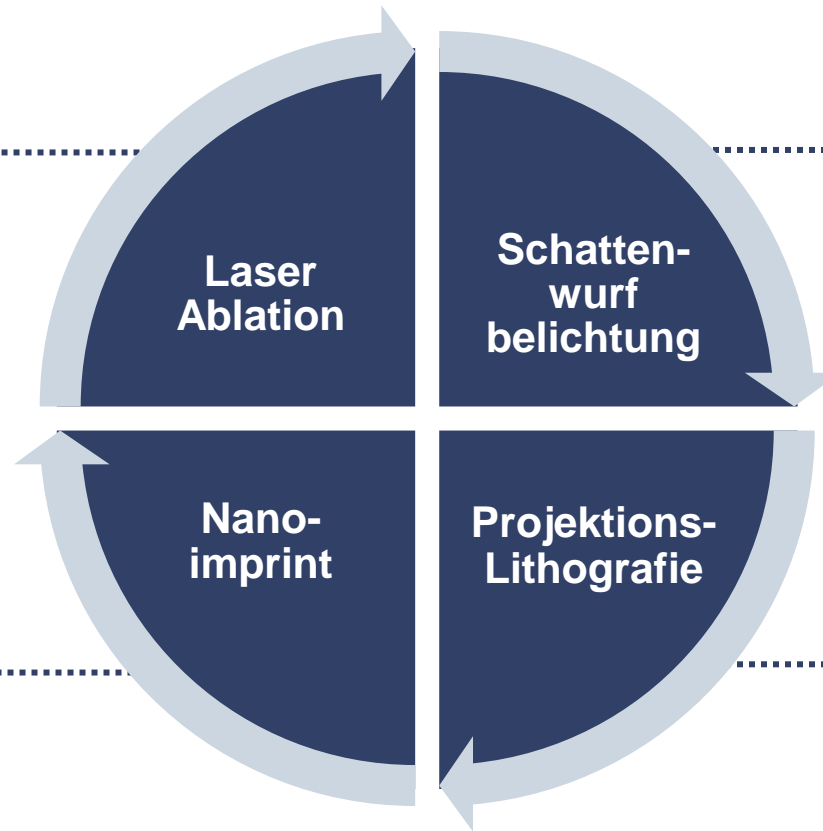




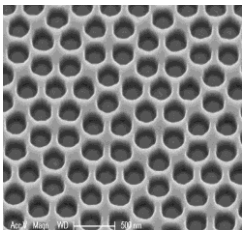
WLCSP:
Fanout WLP



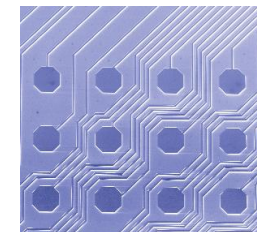
Flip Chip:
Solder Bumping



LED:
Photonic Crystals



WLCSP:
Fine pitch RDL

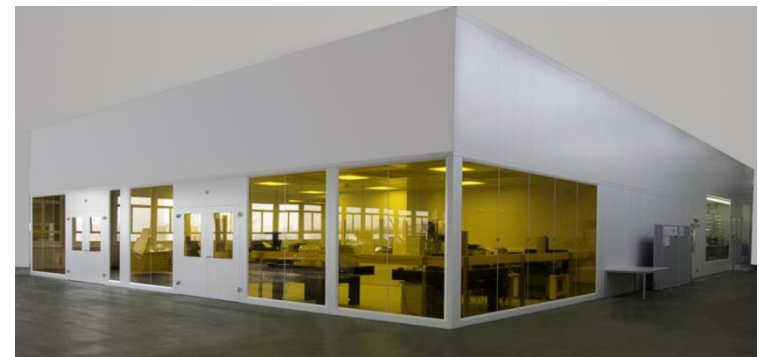


SUSS MicroOptics S.A. ist ein führender Anbieter von Mikrooptiken für den Einsatz im Lithografiebereich der Halbleiterindustrie (Kunden sind z.B. Carl Zeiss, SUSS MicroTec), Telekommunikation sowie der Bereich Forschung und Entwicklung

Unsere Technologie und die innovative Leistungsfähigkeit bilden eine solide Basis für dauerhaftes Wachstum (über die letzten Jahre konnte ein durchschnittliches jährliches Wachstum von ca. 20% erreicht werden)

Im November 2012 ist SUSS MicroOptics in ein neues Produktionsgebäude umgezogen:

- Reinraum der Klasse 100/1000 (415m²)
- Investitionsvolumen: > 2 Mio. €
- Produktionsbeginn war Mitte Dezember 2012
- Mehrschichtbetrieb ist nun möglich

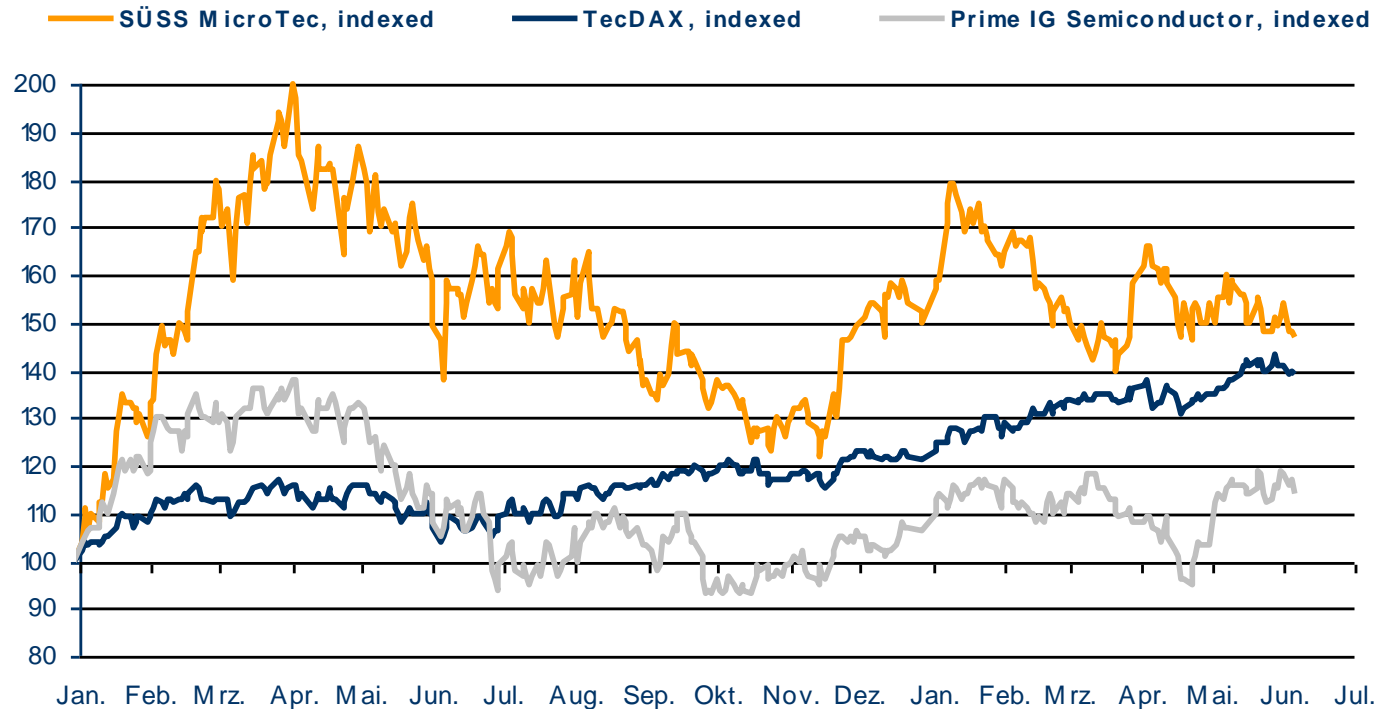


- I. Überblick SÜSS MicroTec AG
- II. Wandel durch technologischen Fortschritt
- III. Meilensteine 2012/2013
- IV. Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V. Das erste Quartal 2013
- VI. Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII. **Die Aktie**
- VIII. Ausblick

AKTIENKURSENTWICKLUNG SÜSS MICROTEC AKTIE 2012/2013

SÜSS MicroTec

(Aktienkurs am 2. Januar 2012: € 5,83)



Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 111.000

- I.** Überblick SÜSS MicroTec AG
- II.** Wandel durch technologischen Fortschritt
- III.** Meilensteine 2012/2013
- IV.** Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
- V.** Das erste Quartal 2013
- VI.** Stärkung des Segments Lithografie – Licht prägt unsere Industrie
- VII.** Die Aktie
- VIII.** **Ausblick**

- + Der Absatz von Smartphones wird im Jahr 2013 um mehr als 30% zunehmen**
- + Der Verkauf von Tablet Computern wird 2013 um rund 60% über Vorjahr liegen**
- + Die weltweiten Ausgaben für IT werden im Jahr 2013 um rund 4% steigen**
- + Der Halbleiterbranche wird im Jahr 2013 voraussichtlich um 3,5% wachsen**
- + Die Investitionen in Technologieknoten <20nm werden im Jahr 2013 beginnen und ab 2014 deutlich ansteigen**
- + Der Markt für Halbleiter Backend Equipment wird 2013 um fast 10% schrumpfen, aber 2014 um 26% ansteigen** (Gartner April 2013)

Quellen: Semi.org, Gartner, IDC

- +** Die Randbedingungen für die Halbleiterbranche und die Equipment Unternehmen des Bereiches entwickeln sich positiv
- +** Die Zielmärkte sind weiterhin von hohem Wachstumspotenzial gekennzeichnet
- +** **2013: Übergangsjahr für SÜSS MicroTec**
 - Refokussierung der Produktlinie permanentes Bonden
 - Integration von SÜSS MicroTec Photonic Systems
- +** Weitere Stärkung der Geschäftsfelder durch Produktinnovation
- +** Kooperation mit führenden Industriepartnern und Forschungsinstituten

Ausblick:

- +** **GJ 2013:**
 - Umsatz ca. 150 Mio. €
 - EBIT: mittlerer-hoher negativer Mio. € Betrag
- +** **Q2 2013:**
 - Auftragseingang 30 - 40 Mio. €

- + TOP 1.** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SÜSS MicroTec AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des zusammengefassten Lageberichts für die SÜSS MicroTec AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
- + TOP 2.** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- + TOP 3.** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
- + TOP 4.** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- + TOP 5.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
- + TOP 6.** Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderungen
- + TOP 7.** Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung
- + TOP 8.** Aufhebung von 4 Abs. 5 und 6 der Satzung
- + TOP 9.** Änderung von 3 Abs. 1 der Satzung



Thank you!

SÜSS MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
85748 Garching

www.SUSS.com